



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月7日

上場会社名 ミツミ電機株式会社

上場取引所 東

コード番号 6767 URL <http://www.mitsumi.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 森部 茂

問合せ先責任者 (役職名) 総務部部長

(氏名) 野口 晋弘

TEL 042-310-5333

四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	76,095	11.4	△1,682	—	△697	—	△1,251	—
25年3月期第2四半期	68,287	△15.8	△4,745	—	△5,433	—	△11,831	—

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 △229百万円 (—%) 25年3月期第2四半期 △13,122百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第2四半期	△14.31	—
25年3月期第2四半期	△135.29	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第2四半期	155,868	101,292	65.0
25年3月期	140,611	101,521	72.2

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 101,292百万円 25年3月期 101,521百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	—	—	0.00	0.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	164,000	7.8	1,500	—	2,000	—	1,500	—	17.15

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年3月期2Q	87,498,119 株	25年3月期	87,498,119 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	46,440 株	25年3月期	46,036 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	87,451,832 株	25年3月期2Q	87,452,425 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報.....	2
(1) 経営成績に関する説明.....	2
(2) 財政状態に関する説明.....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明.....	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項.....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動.....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用.....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示.....	3
3. 四半期連結財務諸表.....	4
(1) 四半期連結貸借対照表.....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書.....	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書.....	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項.....	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
4. 補足情報.....	9
(1) 生産、受注及び販売の状況.....	9
(2) 海外売上高.....	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済の情勢を概観しますと、米国では堅調な個人消費により緩やかな景気回復が見られる一方、欧州では緊縮財政の影響により景気の低迷が継続し、また、新興国の経済成長も緩やかなペースで推移しており、世界経済全体として景気は弱い回復となりました。

日本経済におきましては、為替の円安効果と株価の上昇により、企業業績の回復が見られ、企業の設備投資や個人消費は持ち直し傾向にあります。

当電子部品業界におきましては、デジタルカメラ、パソコン関連市場が低迷する一方で、スマートフォンやタブレット端末等の成長製品や車載関連製品市場の拡大は継続いたしました。

このような経営環境の下、当社グループにおきましては、スマートフォン関連製品や車載関連製品等の売上高が増加した結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は760億9千5百万円(前年同期比111.4%)となりました。

損益につきましては、売上の拡大及び事業構造改革を中心とした改善を進めてまいりましたが、営業損失は16億8千2百万円(前年同期の営業損失は47億4千5百万円)、経常損失は6億9千7百万円(前年同期の経常損失は54億3千3百万円)、四半期純損失は12億5千1百万円(前年同期の四半期純損失は118億3千1百万円)となりました。

当第2四半期連結累計期間における製品集計区分別の業績は、次のとおりであります。

① 半導体デバイス

半導体デバイスにつきましては、モジュール関連製品の受注が減少したことにより、売上高は124億2千4百万円(前年同期比85.3%)となりました。

② 光デバイス

光デバイスにつきましては、スマートフォン用及び車載用カメラモジュールの受注は増加しましたが、アミューズメント用カメラモジュールの受注が減少したことにより、売上高は67億1千2百万円(前年同期比90.1%)となりました。

③ 機構部品

機構部品につきましては、アミューズメント関連製品の受注は横ばいで推移しましたが、カメラモジュール用アクチュエータを中心とした汎用品の受注が増加したことにより、売上高は342億3百万円(前年同期比127.2%)となりました。

④ 高周波部品

高周波部品につきましては、車載関連製品の受注が増加したことにより、売上高は104億1百万円(前年同期比127.2%)となりました。

⑤ 電源部品

電源部品につきましては、携帯端末関連製品の受注が増加したことにより、売上高は123億5千2百万円(前年同期比110.2%)となりました。

前期まで区分掲記しておりました「情報通信機器」は、第1四半期連結累計期間より「機構部品」に含めて表示しております。なお、前年同期比較は、前年同期分を変更後の区分に組み替えて行っております。

(2)財政状態に関する説明

① 当第2四半期の財政状態の変動状況

当第2四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べて152億5千6百万円増加し、1,558億6千8百万円となりました。これは主として、現金及び預金が119億7千7百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が155億1千3百万円、たな卸資産が99億4百万円、有形固定資産が22億4千9百万円増加したことなどによるものです。

負債合計は、前連結会計年度に比べて154億8千5百万円増加し、545億7千6百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が147億8千2百万円増加したことなどによるものです。

純資産合計は、前連結会計年度に比べて2億2千9百万円減少し、1,012億9千2百万円となりました。これは、四半期純損失の計上により利益剰余金が12億5千1百万円減少したことや、円安による為替換算調整勘定が10億1千5百万円変動したことなどによるものです。

以上の結果、当第2四半期連結会計期間における自己資本比率は、前連結会計年度に比べて7.2ポイント減少し65.0%となりました。

② 当第2四半期のキャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より122億3千1百万円減少し、331億3千3百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

仕入債務の増加がありましたが、税金等調整前四半期純損失、売上債権の増加及びたな卸資産の増加により73億4千6百万円の支出(前年同期は77億1百万円の支出)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有形固定資産の売却による収入がありましたが、定期預金の預入による支出、有形固定資産の取得による支出などにより53億5千8百万円の支出(前年同期は161億8千1百万円の支出)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

配当金の支払い等により4百万円の支出(前年同期は3百万円の支出)となりました。

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成25年11月5日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用につきましては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	45,907	33,929
受取手形及び売掛金	34,449	49,962
製品	2,452	2,346
仕掛品	6,512	9,052
原材料及び貯蔵品	20,171	27,641
その他	2,518	2,123
貸倒引当金	△47	△69
流動資産合計	111,962	124,987
固定資産		
有形固定資産	25,006	27,255
無形固定資産	1,152	1,074
投資その他の資産		
その他	2,734	2,787
貸倒引当金	△244	△236
投資その他の資産合計	2,490	2,550
固定資産合計	28,649	30,881
資産合計	140,611	155,868
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,524	35,307
短期借入金	5,737	5,962
未払法人税等	317	451
賞与引当金	1,291	1,306
その他	8,782	9,081
流動負債合計	36,653	52,108
固定負債		
退職給付引当金	810	894
その他	1,626	1,572
固定負債合計	2,437	2,467
負債合計	39,090	54,576
純資産の部		
株主資本		
資本金	39,890	39,890
資本剰余金	43,252	43,252
利益剰余金	30,532	29,280
自己株式	△91	△91
株主資本合計	113,583	112,331
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	29	35
為替換算調整勘定	△12,090	△11,075
その他の包括利益累計額合計	△12,061	△11,039
純資産合計	101,521	101,292
負債純資産合計	140,611	155,868

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	68,287	76,095
売上原価	67,827	72,472
売上総利益	460	3,623
販売費及び一般管理費	5,205	5,305
営業損失(△)	△4,745	△1,682
営業外収益		
受取利息	58	55
受取ロイヤリティー	80	21
為替差益	—	779
その他	202	245
営業外収益合計	341	1,100
営業外費用		
支払利息	21	21
固定資産除却損	43	25
支払補償費	24	61
為替差損	702	—
その他	238	8
営業外費用合計	1,029	116
経常損失(△)	△5,433	△697
特別利益		
固定資産売却益	78	—
特別利益合計	78	—
特別損失		
減損損失	264	149
特別退職金	—	8
事業構造改革費用	967	272
災害による損失	2,012	—
特別損失合計	3,244	430
税金等調整前四半期純損失(△)	△8,599	△1,128
法人税等	3,232	123
四半期純損失(△)	△11,831	△1,251

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
四半期純損失(△)	△11,831	△1,251
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△7	6
為替換算調整勘定	△1,283	1,015
その他の包括利益合計	△1,291	1,022
四半期包括利益	△13,122	△229
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△13,122	△229
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△8,599	△1,128
減価償却費	2,854	3,100
減損損失	264	149
事業構造改革費用	967	272
災害による損失	2,012	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	110	14
退職給付引当金の増減額(△は減少)	45	74
前払年金費用の増減額(△は増加)	479	185
受取利息及び受取配当金	△58	△55
支払利息	21	21
為替差損益(△は益)	△312	283
固定資産売却損益(△は益)	△87	△37
固定資産除却損	43	25
売上債権の増減額(△は増加)	△6,117	△15,112
たな卸資産の増減額(△は増加)	△20,392	△9,694
仕入債務の増減額(△は減少)	24,364	14,336
その他	302	308
小計	△4,103	△7,256
利息及び配当金の受取額	49	54
利息の支払額	△21	△21
特別退職金の支払額	△3,859	△61
補助金の受取額	420	—
保険金の受取額	48	20
事業構造改革費用の支払額	—	△262
法人税等の支払額	△236	△85
法人税等の還付額	—	266
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,701	△7,346
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△11,114	△423
定期預金の払戻による収入	159	225
有形固定資産の取得による支出	△5,160	△5,649
有形固定資産の売却による収入	166	748
無形固定資産の取得による支出	△74	△123
投資有価証券の取得による支出	△156	△137
その他	△1	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,181	△5,358
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△3	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3	△4
現金及び現金同等物に係る換算差額	△713	478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△24,600	△12,231
現金及び現金同等物の期首残高	56,959	45,364
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,358	33,133

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社グループは、電気、通信機器の部品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第2四半期連結累計期間における生産実績を製品集計区分別に示すと、次のとおりであります。

区分	生産高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体デバイス	12,130	84.3
光デバイス	6,702	89.8
機構部品	33,854	126.1
高周波部品	10,505	129.7
電源部品	12,439	109.8
合 計	75,632	111.0

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績を製品集計区分別に示すと、次のとおりであります。

区分	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体デバイス	12,615	87.2	3,287	109.2
光デバイス	8,016	92.1	1,839	95.7
機構部品	35,549	131.7	5,984	121.1
高周波部品	10,836	129.9	2,946	111.0
電源部品	11,858	98.5	2,499	97.1
合 計	78,876	111.8	16,557	109.6

③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績を製品集計区分別に示すと、次のとおりであります。

区分	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体デバイス	12,424	85.3
光デバイス	6,712	90.1
機構部品	34,203	127.2
高周波部品	10,401	127.2
電源部品	12,352	110.2
合 計	76,095	111.4

(2) 海外売上高

前第2四半期連結累計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）（単位 百万円）

	ア ジ ア	欧 州	北 米	計
I 海 外 売 上 高	30,875	1,492	635	33,003
II 連 結 売 上 高				68,287
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	45.2	2.2	0.9	48.3

当第2四半期連結累計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）（単位 百万円）

	ア ジ ア	欧 州	北 米	計
I 海 外 売 上 高	37,874	1,743	2,016	41,633
II 連 結 売 上 高				76,095
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	49.8	2.3	2.6	54.7